

SGI取扱材料熱処理比較表

創業實業(中国)有限公司 工程部 監修

材質型番	熱処理方法	熱処理硬度	備考
SKH51	焼入れ焼戻し	HRC60~64°	コーティングな場合、三回焼戻し必要
SKD11	焼入れ焼戻し/真空焼入れ	HRC58~60°	コーティングな場合、二回焼戻し必要
	光輝焼入れ	HRC55~60°	コーティングの効果は良くない
DC53	焼入れ焼戻し/真空焼入れ	HRC60~62°	コーティングな場合、二回焼戻し必要
	光輝焼入れ	HRC55~60°	コーティングの効果は良くない
SKD61	焼入れ焼戻し/真空焼入れ	HRC50~55°	
	光輝焼入れ	HRC45~50°	
	窒化	HRC50~55°	
SKS3	焼入れ焼戻し (油焼入れ)	HRC55~60°	
SK3(SK105)	焼入れ焼戻し/真空焼入れ	HRC50~55°	硬度高すぎて、部品は変形&裂け易い
SUJ2	焼入れ焼戻し/真空焼入れ	HRC50~55°	
	局部高周波淬火	HRC55~60°	硬度高すぎて、部品は変形&裂け易い
S136	焼入れ焼戻し/真空焼入れ	HRC48~54°	
SUS420J2	真空焼入れ/光輝焼入れ	HRC50~55°	
SUS440C	真空焼入れ/光輝焼入れ	HRC55~60°	
S45C	焼入れ焼戻し	HRC45~50°	硬度高すぎて、部品は変形&裂け易い
	部分電気誘導高周波焼入れ	HRC45~50°	硬度高すぎて、部品は変形&裂け易い
	部分レーザー高周波焼入れ	HRC50~55°	コストは電気誘導高周波焼入れの5倍以上、溝と穴の内径は加工不可
	窒化	HRC50~55°	
S50C	焼入れ焼戻し	HRC45~50°	硬度高すぎて、部品は変形&裂け易い
	部分電気誘導高周波焼入れ	HRC50~55°	硬度高すぎて、部品は変形&裂け易い
	部分レーザー高周波焼入れ	HRC55~60°	コストは電気誘導高周波焼入れの5倍以上、溝と穴の内径は加工不可
	窒化	HRC50~55°	
SCM415	浸炭焼入れ	HRC55~60°	硬度層深さ0.5~1mm
SCM435	浸炭焼入れ	HRC50~55°	硬度層深さ0.5~1mm
	焼入れ焼戻し	HRC45~50°	

※20191202更新